



BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES

EDITAL

PROCESSO COMPETITIVO

01/2026 – BNDES

ALIENAÇÃO EQUIPAMENTOS UNITEC

OBJETO

Alienação de equipamentos de propriedade do BNDES relacionados e descritos no Anexo I – Projeto Básico

INFORMAÇÕES DO EVENTO

INÍCIO

22/05/2026 às 19h
(horário de Brasília-DF)

TÉRMINO

25/06/2026 às 15h
(horário de Brasília-DF)

LOCAL (exclusivamente *online*)

Site: <https://www.superbid.net/>

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

LEI Nº 13.303/2016, ART. 28, §3º,
INCISO I.

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)
LEI Nº 13.709, DE 14/08/2018



Regulamento de Alienação de Bens oriundos da Recuperação de Créditos do Sistema BNDES.

DÚVIDAS SOBRE O EDITAL

- ✉ DÚVIDAS EM RELAÇÃO AO PROCESSO COMPETITIVO DEVEM SER DIRECIONADAS AOS CONTATOS INFORMADOS NESTE EDITAL.

Em até 2 (dois) dias úteis anteriores à data de abertura do evento

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS



A participação neste evento importa na manifestação de inequívoco consentimento do titular, seja ele pessoa física direta ou indiretamente relacionada ao Participante, inclusive sócios, empregados, contratados e/ou terceirizados, quando for o caso, dos dados pessoais que tenham se tornado públicos como condição para participação no evento e para contratação, para tratamento pelo BNDES, na forma da Lei nº 13.709/2018. Poderão ser solicitados pelo BNDES dados pessoais adicionais a fim de viabilizar o cumprimento de obrigação legal.

CRÍTICAS, RECLAMAÇÕES E DENÚNCIAS

Ouvidoria do BNDES

Através de preenchimento do formulário disponível no endereço eletrônico www.bndes.gov.br/ouvidoria

- ✉ Caixa Postal 15054, CEP nº 20.031-120, Rio de Janeiro – RJ

☎ 0800-7026307

ETAPAS

leilão (aberto) (lances na sessão pública)



1 REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA

O evento será realizado exclusivamente on-line através) do Canal Superbid.net (www.superbid.net) e do Canal SOLD (www.sold.superbid.net), e serão conduzidos pelo Pregoeiro indicado no Quadro Resumo.

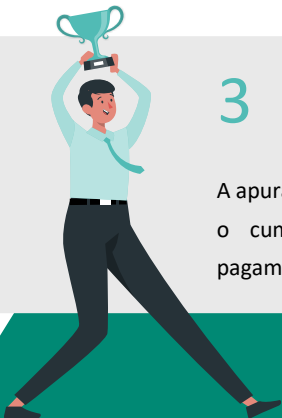
2 ARREMATAÇÃO DO BEM

O Participante cuja oferta observar os valores mínimos estabelecidos neste Edital será declarado arrematante, observadas as regras de priorização.



3 APURAÇÃO DO VENCEDOR

A apuração do lance vencedor acontecerá após o cumprimento das disposições sobre o pagamento.



1. OBJETO

1.1 O presente Edital visa à alienação de bens móveis de propriedade do BNDES relacionados e descritos no Anexo I – Projeto Básico , conforme as especificações deste instrumento Convocatório.

2. QUADRO RESUMO

MODALIDADE DE VENDA:	Leilão
PREGOEIRO:	Sr. Daniel de Sousa Matos - Matrícula 200664
EMPRESA ORGANIZADORA DO EVENTO:	SoldMaisAtivo Intermediação de Ativos Ltda. (SOLD)
GARANTIA:	Os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reserva e de alguns acessórios, componentes e/ou peças.
RESTRICÇÕES PARA COMPRA DOS BENS:	O interessado deverá encaminhar os documentos listados no item 5.9.2 ou 5.9.3, do Anexo I – Projeto Básico, que faz parte integrante das presentes Condições de venda e Pagamento, simultaneamente ao envio da proposta. Para tanto, o usuário poderá encaminhar os documentos no momento da habilitação, seguindo o passo a passo ou na seção “Minha Conta”, na opção “Minhas Habilitações”, localizar o evento e clicar em “Enviar documentos”.
VISITAÇÃO:	Para agendamento de visita, o interessado deverá entrar no lote de interesse e clicar em “Agende agora uma visita para saber mais informações sobre o lote” na página do evento na Plataforma Financeira sbX, com antecedência mínima de 10 dias corridos do encerramento do evento.

COMISSÃO DA EMPRESA ORGANIZADORA DO EVENTO:	Pela intermediação da venda o comprador pagará a SOLD (Buyer's Premium) 4,2% do preço dos bens, no prazo de até 2 dias úteis após a aceitação da proposta. As comissões não estão inclusas no valor dos bens.
PAGAMENTO:	O preço dos bens e da comissão da SOLD deverão ser pagos exclusivamente por meio da Conta sbXPAY, utilizando (i) saldo disponível na conta ou (ii) Pix QR Code. O aporte de recursos na Conta sbXPAY poderá ser realizado através de (i) Boleto Bancário, (ii) Transferência Bancária ou (iii) Cartão de Crédito de titularidade do comprador (Visa e Mastercard), conforme opções e limites disponíveis na descrição dos bens.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS BENS:	O pagamento dos bens deverá ser realizado à vista, sendo 10% do valor do lance em até 2 dias do encerramento do leilão, como sinal, e 90% do valor do lance ("valor restante") em até 30 dias do encerramento do leilão ou antes do início da retirada do bem, o que ocorrer primeiro. Caso o pagamento do valor restante não seja realizado, a compra ficará cancelada e o valor do sinal não será devolvido.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DA COMISSÃO DA EMPRESA ORGANIZADORA DO EVENTO:	O pagamento da comissão SOLD deverá ser realizado à vista.
PRAZO DE PAGAMENTO DA COMISSÃO DA EMPRESA ORGANIZADORA DO EVENTO:	Em até 02 dias úteis após o encerramento do leilão
DOCUMENTO FISCAL EMITIDO PELO VENDEDOR:	Não há
PRAZO PARA ENTREGA DO DOCUMENTO FISCAL:	N/A
TRIBUTOS:	Os tributos incidentes sobre a compra deverão ser pagos diretamente pelo comprador, o qual deverá apresentar ao vendedor o comprovante de pagamento, para liberação do bem adquirido. O vendedor informará ao comprador a forma de pagamento dos tributos.

DOCUMENTAÇÃO/CONDIÇÃO/EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA RETIRADA:	<p>O comprador deverá se informar sobre todas as exigências técnicas da administradora da fábrica para a retirada dos bens, incluindo o intervalo de horário permitido para os trabalhos, os equipamentos autorizados para a desmontagem, movimentação e transporte de carga no ato do agendamento. Os bens poderão ser entregues ao procurador do comprador, mediante apresentação prévia, de procuração estabelecendo poderes específicos para esse ato. A procurações deverão ser encaminhadas para o e-mail: processocompetitivo@bndes.gov.br, devendo a via original ser apresentada por ocasião da entrega dos bens. Eventualmente, poderão ser solicitados documentos ao comprador através do WhatsApp (11) 4950-9400.</p>
PRAZO DE RETIRADA:	<p>120 dias corridos contados da data de comunicação do resultado do Processo Competitivo, mediante agendamento através do telefone/WhatsApp (11) 4950-9400, com antecedência de 48 horas.</p>
PROCURAÇÃO PARA RETIRADA DOS BENS POR TERCEIROS:	<p>Procuração Particular estabelecendo poderes específicos para esse ato.</p>
ABANDONO:	<p>Decorrido o período de 1 dia útil a contar da data limite de retirada sem que os bens tenham sido retirados, os mesmos serão considerados abandonados nos termos do artigo 1.275, III, do Código Civil.</p>
DESISTÊNCIA:	<p>Além do valor previsto no item 6.2 do Anexo I, o comprador se sujeitará à perda dos 4,2% pagos a título de comissão da SOLD</p>
INADIMPLÊNCIA:	<p>Será devido pelo comprador inadimplente o valor correspondente a 10% do lance ofertado.</p>

3. Condições de Venda e Pagamento dos Bens

Estas Condições de Venda e Pagamento estabelecem as regras para participação dos usuários no evento,

as quais deverão ser respeitadas por todos os participantes.

Com a aceitação das presentes Condições de Venda e Pagamento do Evento, os usuários ficam legal e financeiramente responsáveis pelo uso da Plataforma Financeira sbX, pelos atos praticados e pelos lances ofertados. Os usuários desde já concordam que a oferta de lances para aquisição dos bens equivale a uma proposta firme e irrevogável de compra do bem.

Caso não concorde com estas regras, o interessado estará impedido de participar e ofertar lances no evento..

3.1 PREGOEIRO – O presente Leilão será conduzido pelo funcionário Sr. Daniel Sousa Matos Matrícula nº.200664.

3.2 DATA E HORÁRIO - O evento será realizado na data e horário estipulados no Quadro Resumo, considerando-se sempre o horário de Brasília/DF.

O horário previsto para encerramento dos lances será exibido na página do respectivo lote.

3.3 BENS - Os bens são ofertados no ESTADO DE CONSERVAÇÃO e no LOCAL em que se encontram.

O vendedor poderá alterar, desdobrar ou reunir os bens em lotes, ou ainda retirá-los do evento de acordo com o seu critério ou necessidade.

As fotos, descrições de acabamento (tecido, material, cores, etc.) e medidas divulgadas são meramente ilustrativas e não devem ser adotadas como parâmetro para demonstrar o estado dos bens ou influenciar a decisão de oferta de lances para arrematação de bens. Os usuários deverão verificar o estado de conservação dos bens antes de ofertar lances.

O vendedor, a Plataforma Financeira sbX e a SOLD não se responsabilizam por eventuais senhas, segredos, códigos ou cadastros necessários para a utilização de bens adquiridos no evento, incluindo a necessidade de eventuais desbloqueios. A verificação da necessidade ou existência destes é exclusiva dos interessados durante a visitação dos bens. Informações individualizadas dos bens, como IMEIs, modelos, números de série, ou quaisquer outros códigos de identificação dos mesmos podem não constar da Nota Fiscal ou Recibo de Venda emitidos pelo vendedor, se o caso.

O vendedor, a Plataforma Financeira sbX, o Canal Superbid.net e o Canal SOLD não garantem a regularidade mecânica, elétrica, eletrônica ou hidráulica dos bens e veículos ofertados no evento, bem como de suas peças, estruturas e componentes.

Serão de responsabilidade do comprador todas as despesas decorrentes da eventual necessidade de troca de partes e peças dos bens e veículos ofertados no evento ou sua regularização junto aos órgãos competentes.

Os bens ofertados não foram testados. A responsabilidade pelo teste é do comprador durante a visitação. Em caso de dúvida ou na impossibilidade de testar/obter informações ou visitar os bens, não devem ser ofertados

lances, pois os mesmos não poderão ser cancelados e também não serão aceitas reclamações ou devoluções após a arrematação.

3.4 GARANTIA - Exceto quando indicado no Quadro Resumo, os bens serão vendidos NO ESTADO em que se encontram, SEM GARANTIA e SEM DIREITO A TROCA, podendo apresentar avarias, amassados, riscos, sujeira, ausência de embalagem, dos manuais, chaves reserva e de alguns acessórios, componentes e/ou peças e/ou ser inservíveis ao uso a que se destinam.

3.5 RESTRIÇÕES PARA COMPRA DOS BENS - Eventuais restrições para compra dos bens, tais como o Estado da sede/domicílio do comprador em função de questões tributárias/operacionais, constam do Quadro Resumo.

3.6 VISITAÇÃO - Cabe aos usuários vistoriar os bens nas datas determinadas pelo vendedor, conforme previsto no Quadro Resumo.

Não são fornecidas por telefone ou e-mail informações relativas às medidas, peso e estado de conservação dos bens.

As fotos divulgadas são meramente ilustrativas e não devem ser adotadas como parâmetro para demonstrar o estado dos bens ou influenciar na decisão de compra. Os interessados deverão verificar o estado de conservação dos bens antes da apresentação da proposta.

Durante a visitação dos bens é proibido entrar de bermuda, camiseta regata, chinelo, portando bolsas, mochilas, sacolas e afins, bem como com crianças ou animais. Os visitantes deverão se comportar com bons modos nas dependências do vendedor, caso contrário serão convidados a se retirar.

3.7 LANCES - Os lances poderão ser ofertados no Canal Superbid.net e/ou Canal SOLD a qualquer momento desde a divulgação dos lotes até o encerramento do evento e/ou presencialmente no Auditório Superbid na data do encerramento do evento.

A Plataforma Financeira sbX permite o recebimento de lances virtuais simultaneamente aos presenciais e em tempo real. Lances ofertados através do Canal Superbid.net, do Canal SOLD ou presencialmente concorrem em igualdade de condições.

A Plataforma Financeira sbX, a seu exclusivo critério, poderão recusar ou cancelar qualquer lance, ainda que vencedor, sempre que: (i) não for possível confirmar a identidade do usuário; (ii) não tenha sido ofertado de boa-fé; (iii) tenha sido realizado com a intenção de manipular o resultado do evento; (iv) o usuário for inadimplente em outro evento divulgado na Plataforma Financeira sbX; (v) o usuário infringir os Termos e Condições de Uso da PLATAFORMA FINANCEIRA sbX E DA CONTA DE PAGAMENTO sbXPAY, ou (vi) seja proibido por qualquer legislação aplicável ou caso o usuário venha a descumprir qualquer disposição constante das presentes Condições de Venda e Pagamento. A manipulação do preço de venda dos bens, direta ou indiretamente, por qualquer usuário é estritamente proibida. São proibidos a oferta de lances em nome de outra pessoa, como também o conluio de usuários compradores e/ou vendedores.

Os usuários poderão ofertar mais de um lance para um mesmo bem, prevalecendo sempre o maior lance ofertado. O usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome.

Todos os lances ofertados são IRREVOGÁVEIS e IRRETRATÁVEIS. Os lances não podem ser anulados e/ou cancelados em nenhuma hipótese.

O encerramento do período de recebimento de lances para aquisição de cada lote respeitara o cronômetro regressivo indicado na Plataforma Financeira sbX. Em caso de atraso no apregoamento dos lotes em função de grande número de ofertas de lances, o horário de encerramento das ofertas de lances dos demais lotes poderão ser prorrogado para melhor divulgação.

3.8 EXTENSÃO DO PRAZO PARA OFERTA DE LANCES - Caso algum lance seja recebido com o cronômetro regressivo indicando menos de 3 minutos para encerramento da oferta de lances para determinado lote, o prazo para oferta de lances será estendido e o cronômetro retroagirá a 3 minutos.

A extensão do período de oferta de lances poderá ocorrer múltiplas e sucessivas vezes até que transcorram 3 minutos sem nenhum lance.

3.9 LOTES SINCRONIZADOS - O horário previsto para encerramento da oferta de lances para aquisição de dois ou mais lotes poderá ser sincronizado, de modo que o encerramento das ofertas seja conjunto.

Se um novo lance for ofertado para aquisição de um dos lotes sincronizados com o cronômetro regressivo indicando menos de 1min20s para encerramento da oferta de lances, o prazo de encerramento da oferta de lances para todos os lotes sincronizados será estendido e o cronômetro retroagirá a 1min20s.

A extensão do período de oferta de lances para aquisição de lotes sincronizados poderá ocorrer múltiplas e sucessivas vezes até que transcorram 1min20s sem lances para qualquer dos lotes sincronizados no mesmo grupo.

3.10 LANCES AUTOMÁTICOS - A qualquer momento durante o período de recebimento de lances, o ofertante poderá programar lances automáticos definindo um limite máximo, de forma que, se outro ofertante cobrir o lance vigente, o sistema automaticamente inserirá um novo lance em seu nome, acrescentando um incremento mínimo fixo e pré-determinado, até o limite máximo definido no lance automático.

Os lances automáticos ficarão registrados ocultamente no sistema com a data em que forem programados.

Quando um lance manual é ofertado e atinge o valor máximo de um lance automático programado, o sistema não gerará o lance automático em função da existência de lance manual no mesmo valor do máximo programado.

3.11 VALOR MÍNIMO DE VENDA - É o valor mínimo estipulado pelo vendedor para a venda do bem.

O valor mínimo de venda pode ser diferente do valor do lance inicial exibido na página do lote na Plataforma Financeira sbX.

O valor mínimo de venda não será revelado aos usuários.

Quando o lance ofertado superar o valor mínimo de venda do bem, uma mensagem será exibida para este ofertante na Plataforma Financeira sbX.

3.12 LANCE VENCEDOR - Declarado vencedor, o lance ofertado equivale a uma proposta firme e irrevogável de compra do bem. O usuário comprador será comunicado da venda por e-mail ou por notificação gerada automaticamente pela Plataforma Financeira sbX.

3.13 COMISSÃO DA EMPRESA ORGANIZADORA DO EVENTO - O comprador deverá pagar a Empresa Organizadora do Evento a Comissão prevista no Quadro Resumo, no prazo igualmente previsto no Quadro Resumo.

3.14 FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento dos bens e das comissões deverá ser realizado no prazo previsto no Quadro Resumo, exclusivamente por meio da Conta sbXPAY, utilizando (i) saldo disponível na conta ou (ii) Pix QR Code.

O aporte de recursos na Conta sbXPAY poderá ser realizado através de (i) Boleto Bancário, (ii) Transferência Bancária ou (iii) Cartão de Crédito de titularidade do comprador (Visa e Mastercard), conforme opções e limites disponíveis na descrição do lote. Os recursos aportados na Conta sbXPAY somente estarão disponíveis após a compensação.

O aporte de recursos está sujeito à cobrança de tarifas. As tarifas poderão ser consultadas através da opção "Fale Conosco", localizada na parte superior da página inicial do site. Na opção Fale Conosco, digitar "Tarifas". Tais tarifas não serão estornadas em nenhuma hipótese, mesmo em caso de cancelamento da compra. A Conta sbXPAY deve ser utilizada exclusivamente para pagamentos de bens ou serviços na Plataforma Financeira sbX.

Caso o pagamento deva ser realizado diretamente na conta bancária do vendedor, em instituição financeira, tal informação constará da seção "Minha Conta". O respectivo comprovante deverá ser enviado para o e-mail: cobranca@superbid.net.

A Plataforma Financeira sbX não envia por e-mail boletos bancários ou QR Code Pix; esses devem ser acessados exclusivamente através da seção "Minha Conta".

Os boletos bancários têm como beneficiária a Superbid Pay Instituição de Pagamento Ltda., CNPJ nº 35.084.163/0001-84. Não é necessário o envio dos comprovantes dos boletos pagos.

3.15 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

3.15.1 PAGAMENTO À VISTA - O preço do bem adquirido deverá ser pago no prazo constante do Quadro Resumo.

3.15.2 PAGAMENTO PARCELADO - O preço do bem adquirido poderá ser pago parcelado exclusivamente quando disponível a opção Cartão de Crédito.

3.15.3 PAGAMENTO FINANCIADO - O preço do bem adquirido poderá ser financiado, se indicado na descrição do lote, conforme regras abaixo.

O comprador poderá, a seu critério, financiar o valor do bem adquirido com uma das instituições financeiras informadas na Plataforma Financeira sbX, sendo de sua total responsabilidade obter aprovação de seu crédito previamente ao encerramento do evento, bem como celebrar o respectivo Contrato de Financiamento e efetuar o pagamento: (i) do valor da entrada estipulada pela instituição financeira escolhida pelo comprador, (ii) da Comissão da SOLD, e (iii) do Fee Plataforma, dentro do "Prazo de Pagamento".

No caso de não celebração do Contrato de Financiamento, fica o comprador obrigado ao pagamento à vista dos valores devidos pela aquisição dos bens (valor do bem, Comissões e Fee Plataforma) no “Prazo de Pagamento” estipulado no Quadro Resumo, sob pena de ficar sujeito ao pagamento do valor devido pela inadimplência.

A SOLD, a Plataforma Financeira sbX e a sbXPAY não assumem qualquer corresponsabilidade ou coobrigação pela aprovação do crédito do comprador, contratação do financiamento ou seu adimplemento perante a instituição financeira.

3.16 NOTA FISCAL/RECIBO EMITIDO PELO VENDEDOR - O documento fiscal emitido pelo vendedor está previsto no Quadro Resumo. Caso o vendedor não emita Nota Fiscal ou Recibo de Venda, tal informação constará igualmente do Quadro Resumo.

A Nota Fiscal ou o Recibo de Venda será emitido apenas em nome do comprador, de acordo com os dados constantes do cadastro na Plataforma Financeira sbX na data da compra. A Nota Fiscal ou o Recibo de Venda não serão emitidos em nome de terceiros.

A Nota Fiscal ou Recibo de Venda, quando emitido, estará disponível para retirada juntamente com o bem adquirido.

Caso o vendedor emita somente Recibo de Venda ou não emita documento fiscal, o comprador deverá providenciar a emissão de Nota Fiscal Avulsa para Transporte e/ou Nota Fiscal de Entrada, bem como o recolhimento de ICMS e demais tributos relativos aos bens adquiridos, quando devidos.

O vendedor, a SOLD, a Plataforma Financeira sbX e a sbXPAY não se responsabilizam pela emissão de Nota Fiscal Avulsa para Transporte e/ou Nota Fiscal de Entrada, tampouco por qualquer multa ou eventual apreensão dos bens pela fiscalização.

Para a emissão das Notas Fiscais dos bens, os compradores deverão estar regularmente inscritos e com seu endereço atualizado perante a Receita Federal do Brasil (Pessoa Física/Pessoa Jurídica) e no SINTEGRA - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Contribuintes do ICMS), sob pena de perder o direito ao bem e aos valores pagos.

3.17 NOTA FISCAL DA SOLD - A Nota Fiscal da SOLD será emitida até a liberação da retirada do lote pelo vendedor, somente em nome do comprador, conforme dados constantes do cadastro da Plataforma Financeira sbX na data da arrematação.

A Nota Fiscal da SOLD será enviada aos compradores via e-mail, depois de confirmados os pagamentos dos valores devidos.

3.18 DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO - O Demonstrativo de Pagamento será emitido em nome do comprador, conforme dados constantes do cadastro na Plataforma Financeira sbX na data da compra. O Demonstrativo de Pagamento será disponibilizado na Plataforma Financeira sbX, depois de confirmados os pagamentos dos valores devidos, na seção “Minha Conta/Minhas Compras” da Wallet sbX, entrar no Pedido, clicar em “Ver mais” e, nos Detalhes da compra, imprimir o Demonstrativo de Pagamento.

3.19 TRIBUTOS - O responsável pelo pagamento dos tributos constará do Quadro Resumo.

3.20 DOCUMENTAÇÃO/CONDIÇÃO/EQUIPAMENTO ESPECIAL PARA RETIRADA - Caso o vendedor exija do comprador documentos especiais e/ou condições especiais e/ou equipamentos específicos, para retirada dos bens adquiridos, tais previsões constarão do Quadro Resumo.

Caso o comprador não cumpra as exigências do vendedor, a compra poderá ser cancelada, perdendo o comprador a integralidade dos valores pagos.

3.21 LIBERAÇÃO DO LOTE / PRAZO DE RETIRADA - Os bens arrematados serão disponibilizados pelo vendedor e deverão ser retirados pelos compradores ou terceiros por eles indicados integralmente.

Para liberação da retirada dos bens adquiridos o comprador deverá apresentar (i) documento de identificação com foto e (ii) Demonstrativo de Pagamento.

Se a retirada for realizada por terceiro ou transportadora é obrigatória a apresentação de procuração, conforme previsto no Quadro Resumo.

Durante a retirada dos bens é proibido entrar de bermuda, camiseta regata, chinelo, portando bolsas, mochilas, sacolas e afins, bem como com crianças ou animais. Os compradores, seus representantes ou a transportadora responsável deverão se comportar com bons modos nas dependências do vendedor, caso contrário serão convidados a se retirar.

As despesas com a retirada dos bens adquiridos, do local onde se encontram até o destino final, são de responsabilidade dos compradores.

Essas despesas incluem, mas não se limitam a desmontagem, embalagem, remoção, carregamento, içamento, cuidados especiais, transporte nacional ou internacional, seguros, despachos, permissões e a mão de obra necessária à execução desses serviços.

A SOLD e a Plataforma Financeira sbX não têm qualquer responsabilidade pela entrega aos compradores dos bens adquiridos e respectivos documentos, se o caso.

O comprador é responsável por quaisquer danos que venha a causar às instalações do vendedor, aos pátios em que os bens estão armazenados, aos bens adquiridos ou a bens de terceiros, devendo reparar tais danos.

É facultado ao vendedor reter os bens adquiridos visando garantir o ressarcimento dos danos causados.

O comprador, seu procurador ou a transportadora responsável pela retirada dos bens devem seguir todas as regras de segurança de modo a não causar danos físicos aos mesmos ou a terceiros. Qualquer eventual acidente será de inteira e exclusiva responsabilidade do comprador.

Caso no ato da retirada seja constatada infração a qualquer norma de segurança ou situação que possa causar risco físico aos presentes no local, poderá ser solicitada a imediata suspensão da retirada, somente sendo possível a continuação após o efetivo cumprimento das exigências de segurança, sem que tal fato gere qualquer responsabilidade para a Plataforma Financeira sbX, para o Canal Superbid.net e para o Canal SOLD Venda ou direito para o comprador retirar o bem em outro dia fora do prazo de retirada.

No ato da retirada, o comprador, seu procurador ou a transportadora responsável pela retirada deverá conferir o conteúdo e as condições dos bens adquiridos. Havendo qualquer divergência ou irregularidade, o fato deverá ser imediatamente informado ao vendedor e à Plataforma Financeira sbX, devendo o comprador suspender a retirada até que estejam solucionadas as dúvidas existentes. A comunicação à Plataforma Financeira sbX deverá ser feita por meio da seção “Minhas Compras” da Wallet sbX, clicando em “Relatar um Problema” ao lado do lote adquirido, onde será aberto um ticket. O comprador deverá selecionar uma das opções disponíveis e descrever detalhadamente o ocorrido. O sistema disponibilizará um número de protocolo para acompanhamento do ticket.

A partir da retirada o comprador reconhece e aceita o conteúdo e conformidade do bem.

Não serão aceitas quaisquer reclamações dos compradores com relação a irregularidades e/ou divergências do bem após a retirada.

3.22 REQUISITOS DE SEGURANÇA - No acesso às dependências do vendedor e/ou aos pátios em que os bens estão armazenados para visita e/ou retirada, o interessado, o comprador, procurador ou empresa transportadora contratada pelo comprador deverá respeitar e cumprir todas as normas internas de segurança e todos os requisitos de segurança estabelecidos pela legislação em vigor, não cabendo ao vendedor, à Plataforma Financeira sbX e à SOLD qualquer responsabilidade por acidentes ocorridos durante a visita e retirada dos bens.

3.23 DESCARACTERIZAÇÃO DE BENS - Será de responsabilidade do comprador descaracterizar toda e qualquer identificação do vendedor no bem ou veículo adquirido.

3.24 ABANDONO DO BEM - Caso o bem adquirido não seja retirado, o mesmo será considerado abandonado no prazo constante do Quadro Resumo, nos termos do artigo 1.275, III, do Código Civil.

Neste caso, o comprador desde já autoriza que sejam tomadas quaisquer ações necessárias para dar destino ao bem, não sendo devolvido nenhum valor ao comprador.

3.25 INADIMPLÊNCIA - Caso o comprador não pague os valores devidos em função das arrematações no “Prazo de Pagamento” definido no Quadro Resumo, a arrematação ficará cancelada e deverá o comprador pagar o valor correspondente a 10% do lance ofertado (“Valor da Inadimplência”). Nessa hipótese, será devido o valor da inadimplência indicado no Quadro Resumo, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades previstas neste instrumento e na legislação aplicável.

O comprador desde já autoriza a Plataforma Financeira sbX, o Canal Superbid.net, o Canal SOLD e a sbXPAY a reter e/ou debitar do saldo da conta sbXPAY do comprador o valor da inadimplência.

Em caso de inadimplência a caução ofertada pelo comprador, se o caso, não será devolvida.

O comprador inadimplente não será admitido a participar de qualquer evento realizado na Plataforma Financeira sbX, pelo que seu cadastro ficará bloqueado. Caso sejam identificados cadastros vinculados a este cadastro bloqueado, os mesmos serão igualmente bloqueados.

3.26 MODIFICAÇÃO - A Plataforma Financeira sbX poderá, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, acrescentar, extinguir ou alterar alguns ou todos os serviços por ela disponibilizados.

3.27 LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE - A responsabilidade da Plataforma Financeira sbX está limitada à disponibilização da infraestrutura tecnológica financeira para a promoção de transações no comércio eletrônico entre vendedores e compradores.

A Plataforma Financeira sbX não garante o acesso contínuo de seus serviços, uma vez que sua operação está sujeita a interferências decorrentes de fatores fora do seu controle. A Plataforma Financeira sbX não será responsável por qualquer prejuízo eventualmente acarretado aos interessados por dificuldades técnicas ou falhas na comunicação ou acesso à Internet.

A SOLD, a Plataforma Financeira sbX e o vendedor não garantem que os bens estão operando apropriadamente ou que continuarão operando apropriadamente por qualquer período após a retirada.

O vendedor garante que é o proprietário dos bens, tem o direito de vendê-los e sua venda não viola qualquer lei ou obrigação de propriedade intelectual.

O vendedor responde perante os compradores pela veracidade das informações veiculadas, pela transação de venda e compra, pela entrega dos bens adquiridos nas condições ofertadas, assim como pela origem, existência e legitimidade dos bens ofertados.

O usuário autoriza a Plataforma Financeira sbX a compartilhar os dados do seu cadastro com a SOLD, com a sbXPAY e com o vendedor.

A Plataforma Financeira sbX, a SOLD e a Superbid Pay não se responsabilizam por prejuízos ou quaisquer tipos de danos advindos das transações efetuadas entre os compradores e o vendedor.

O interessado/comprador concorda em defender, indenizar e isentar a Plataforma Financeira sbX, a Superbid Pay e o vendedor por danos de qualquer natureza, a pessoas ou propriedades, causados pelo interessado/comprador ou seu procurador durante a visita dos bens ou resultantes da compra ou uso dos bens adquiridos, incluindo honorários advocatícios.

O interessado/comprador concorda ainda em defender, indenizar e isentar o vendedor, a SOLD, a Plataforma Financeira sbX e a Superbid Pay e suas companhias afiliadas e seus gerentes, diretores, empregados, agentes, sucessores e cessionários de quaisquer reivindicações, danos ou demandas (inclusive, mas não limitado a, quaisquer danos pessoais, morte ou danos a propriedade sofridos por qualquer terceiro, assim como custas e honorários advocatícios e de peritos), decorrentes de (a) descumprimento, pelo interessado/comprador, das presentes Condições de Venda e Pagamento, (b) uso impróprio, pelo interessado/comprador, da Plataforma, a SOLD, Financeira sbX, (c) uso, pelo comprador, de qualquer bem adquirido por meio da Plataforma Financeira sbX, (d) violação, pelo interessado/comprador, de qualquer lei ou regulamento aplicável ou dos direitos de terceiros e (e) uso, pelo interessado/comprador, de quaisquer equipamentos, programas ou procedimentos que interfiram ou prejudiquem o funcionamento da Plataforma Financeira sbX.

O interessado/comprador responderá civil e criminalmente pelo uso de equipamento, programa ou procedimento que possa interferir dolosamente no funcionamento adequado da Plataforma Financeira sbX.

3.28 DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E ACEITAÇÃO - Ao participar do Processo Competitivo, o interessado

declara que leu, entendeu e concordou com todos os termos constantes das presentes Condições de Venda e Pagamento.

4. HABILITAÇÃO



4.1 Após o encerramento da fase de envio de lances, a habilitação do vencedor dar-se-á pelo pagamento da quantia correspondente a 10% (dez por cento) do valor do lance vencedor.



4.2 A importância paga como sinal será utilizada para complementação do preço total de arrematação.

4.3 Se não houver pagamento do sinal, haverá a convocação do próximo colocado, se houver.

5. ETAPA RECURSAL



5.1 Eventuais recursos deverão ser interpostos no prazo de **2 (dois) dias úteis**, contados a partir do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado da alienação, na plataforma Superbid, dirigidos ao BNDES necessariamente, entregues pelo e-mail processocompetitivo@bndes.gov.br, até as 17h30, sob pena de preclusão.

5.1.1 Os recursos devem ser apresentados por escrito, de forma legível e assinados pelo Representante Legal, ou Procurador com poderes específicos, devidamente constituído.

5.2 O Julgamento do recurso, se houver, será disponibilizado no site do **BNDES** (www.bndes.gov.br).

5.3 O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.



5.4 Na ausência de recursos ou após o julgamento dos recursos eventualmente interpostos, o resultado final da alienação estará sujeito à homologação pela Autoridade Superior competente.

6. ENCERRAMENTO

6.1 Antes da transferência da posse dos bens alienados, o(s) Arrematante(s) vencedor(es) deverá(ão) encaminhar ao BNDES, Declaração de não impedimento em contratar com o BNDES (ANEXO II)

7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

7.1 O **BNDES** e a Plataforma Financeira sbX reservam-se ao direito de alterar os termos deste **EDITAL**. A alteração que afetar a formulação das propostas implicará a reabertura do prazo para a apresentação das mesmas.

7.2 A qualquer tempo, a licitação poderá ser revogada ou anulada, nos limites fixados pela Lei nº 13.303/2016.

7.2.1 Caso seja verificada, após a abertura da sessão pública, a intenção de revogar ou anular a licitação, será concedido aos Licitantes prazo para contestar o ato e exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa.

7.3 A responsabilidade da Plataforma Financeira sbX está limitada à disponibilização da plataforma de intermediação para a promoção de transações no comércio eletrônico entre vendedores e compradores.

7.4 A Plataforma Financeira sbX não garante o acesso contínuo de seus serviços, uma vez que sua operação está sujeita a interferências decorrentes de fatores fora do seu controle. A Plataforma Financeira sbX não será responsável por qualquer prejuízo eventualmente acarretado aos usuários por dificuldades técnicas ou falhas na comunicação ou acesso à Internet.

7.5 A SOLD, a Plataforma Financeira sbX e o vendedor não garantem que os bens estão operando apropriadamente ou que continuarão operando apropriadamente por qualquer período após a retirada.

7.6 O vendedor garante que é o proprietário dos bens, tem o direito de vendê-los e sua venda não viola qualquer lei ou obrigação de propriedade intelectual.

7.7 O vendedor responde perante os usuários compradores pela veracidade das informações veiculadas, pela transação de venda e compra, pela entrega dos bens arrematados nas condições ofertadas, assim como pela origem, existência e legitimidade dos bens ofertados.

7.8 A Plataforma Financeira sbX, a SOLD e a Superbid Pay não se responsabilizam por prejuízos ou quaisquer tipos de danos advindos das transações efetuadas entre os usuários compradores e o vendedor.

7.9 O usuário concorda em defender, indenizar e isentar o vendedor, a Plataforma Financeira sbX e a SOLD por danos

de qualquer natureza, a pessoas ou propriedades, causados pelo usuário, seu procurador e/ou transportadora durante a visitaçã o e retirada dos bens ou resultantes da compra, uso ou operação do bem adquirido, incluindo honorários advocatícios.

7.10 O usuário concorda ainda em defender, indenizar e isentar o vendedor, a SOLD, a Plataforma Financeira sbX e a Superbid Pay e suas companhias afiliadas e seus gerentes, diretores, empregados, agentes, sucessores e cessionários de quaisquer reivindicações, danos ou demandas (inclusive, mas não limitado a, quaisquer danos pessoais, morte ou danos a propriedade sofridos por qualquer terceiro, assim como custas e honorários advocatícios e de peritos), decorrentes de (a) descumprimento, pelo usuário, dos termos e regras das presentes Condições de Venda e Pagamento, (b) uso impróprio, pelo usuário, da Plataforma Financeira sbX, (c) uso,

pelo usuário, de qualquer bem adquirido por meio da Plataforma Financeira sbX, (d) violação, pelo usuário, de qualquer lei ou regulamento aplicável ou dos direitos de terceiros e (e) uso, pelo usuário, de quaisquer equipamentos, programas ou procedimentos que interfiram ou prejudiquem o funcionamento da Plataforma Financeira sbX.

7.11 O interessado em participar do evento responderá civil e criminalmente pelo uso de equipamento, programa ou procedimento que possa interferir dolosamente no funcionamento adequado da Plataforma Financeira sbX.

7.12 O usuário que descumprir as presentes Condições de Venda e Pagamento será bloqueado para participar dos eventos divulgados pela Plataforma Financeira sbX através da internet, devendo comparecer pessoalmente no evento presencial.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2026.

ANEXO I – PROJETO BÁSICO

PROJETO BÁSICO

1. OBJETO:

- 1.1. Alienação de equipamentos dados em garantia como propriedade fiduciária, provenientes de créditos inadimplidos da empresa UNITEC SEMICONDUTORES S/A. Os bens são oriundos de processo de recuperação de crédito.

2. LOCALIZAÇÃO DOS BENS:

- 2.1. Os equipamentos estão localizados dentro da Unidade Industrial da UNITEC SEMICONDUTORES S/A, na Rodovia BR-040, km 508,5, s/nº – Veneza – Ribeirão das Neves – MG, CEP: 33.820-152 (Google Maps Plus Codes: 6VJJ+FV Veneza, Ribeirão das Neves - MG).
- 2.2. A descrição dos bens disponíveis para aquisição é apresentada no item 3 a seguir.

3. DESCRIÇÃO DOS BENS E A INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS À VENDA:

- 3.1. Os bens incluídos neste processo de alienação consistem em equipamentos adquiridos para a produção e projeto de semicondutores. Todos os itens estão fora de uso e sem manutenção.
- 3.2. Boa parte dos equipamentos nunca entrou em operação, estando em suas embalagens originais, preservadas ou não, sem garantia de fabricação e operação, sendo que alguns notadamente com componentes retirados.
- 3.3. O **BNDES** não garante o funcionamento dos bens.
- 3.4. Lista dos bens (262 equipamentos):

Descrição	Quantidades
AVP kit de atualização: AVP computador de gerenciamento - Mod: SPTS AMS Server	1
BOMBA A VACUO 40x20	2
BOMBA A VACUO 40x20	1
BOMBA A VACUO A07V	3
BOMBA A VACUO A10S	2
BOMBA A VACUO A70W	4
BOMBA A VACUO A70W	1
BOMBA A VACUO A70W	6
BOMBA A VACUO A70W	1
BOMBA A VACUO A70WN	1
BOMBA A VACUO A70WN	1
BOMBA A VACUO EV-S100P	3
BOMBA A VACUO EV-S100P	2
Bombas de vácuo A10S	1
Bombas de vácuo A10S	5
Bombas de vácuo A10S	8
Bombas de vácuo A10S	6

Bombas de vácuo A10S	6
Bombas de vácuo A10S	2
Bombas de vácuo A70W	1
Bombas de vácuo A70W	6
Bombas de vácuo A70W	1
Bombas de vácuo A70W	1
Bombas de vácuo A70W	6
CL60K01 - Linha de Conversão RFID - Fabr: Mühlbauer Mod: CL 60000	1
CME01 - Encapsuladora Smart Chip - Fabr: Mühlbauer Mod: CME 3060	1
CMT01 - Teste de Encapsulamento Smart Chip - Fabr: Mühlbauer Mod: CMT 6560	1
CMT02 - Teste de Encapsulamento Smart Chip - Fabr: Mühlbauer Mod: CMT 6560	1
DB01 - Die Bonder Smart Chip - Fabr: ESEC Mod: DB 2008 SC	1
DB02 - Die Bonder Smart Chip - Fabr: ESEC Mod: DB 2008 SC	1
DB03 - Die Bonder Smart Chip - Fabr: ESEC Mod: DB 2008 SC	1
DSPA10 - Removedor de polímeros por plasma - Fabr: Axcelis Mod: Gemini GES	1
DSPA11 - Removedor de polímeros por plasma - Fabr: Axcelis Mod: Gemini GES	1
DSPA12 - Removedor de polímeros por plasma - Fabr: Fusion Mod: Gemini GPL	1
DSPA13 - Removedor de polímeros por plasma - Fabr: Fusion Mod: Gemini GES	1
DSPA14 - Removedor de polímeros por plasma - Fabr: Fusion Mod: Gemini GPL	1
DSPA20 - Removedor de polímeros por plasma - Fabr: EATON Mod: Gemini GES	1
DSPA21 - Removedor de polímeros por plasma - Fabr: FUSION Mod: Gemini GPL	1
DSPA22 - Removedor de polímeros por plasma - Fabr: Fusion Mod: Gemini GES	1
EFPE10 - LAM Kiyosystem - Fabr: LAM Mod: 2300	1
FAIA10 - Microscópio eletrônico de varredura utilizado para a caracterização microestrutural de semicondutores - Fabr: HITACHI Mod: S-4700	1
FAIA21 - Equipamento baseado em feixes de íons focalizados, para eliminação de matéria, análise e modificação de circuitos integrados - Fabr: CREDENCE Mod: OPTIFIB III	1
FAIA40 - Microscópio óptico - Fabr: NIKON Mod: OPTIPHOT 200C	1
FAIA41 - Microscópio óptico - Fabr: LEICA Mod: POLYVAR-MET	1
FAIA42 - Microscópio óptico - Fabr: ZEISS Mod: AXIOTRON	1
FAIA60 - Equipamento para elevação e movimentação de plaquetas (wafers), de dispositivos semicondutores e circuitos eletrônicos integrados provendo contatos elétricos - Fabr: KARL SUSS Mod: PA200	1
FASP10 - Equipamento de deposição de metais utilizado nas plaquetas (wafers) de dispositivos semicondutores para a fabricação de circuitos integrados eletrônicos - Fabr: OXFORD Mod: PLASMALAB 80	1
FASP11 - Equipamento de deposição de metais utilizado nas plaquetas (wafers) de dispositivos semicondutores para a fabricação de circuitos integrados eletrônicos - Fabr: NEXTRAL Mod: NE90	1
FASP40 - Equipamento de deposição de metais utilizado nas plaquetas (wafers) de dispositivos semicondutores para a fabricação de circuitos integrados eletrônicos - Fabr: MSCOPE Mod: SC500	1
FASP60 - Equipamento para polimento de wafers utilizado na fabricação de dispositivos semicondutores - Fabr: PRESI Mod: MINITECH 233	1
FASP61 - Equipamento para polimento de wafers utilizado na fabricação de dispositivos semicondutores - Fabr: BUEHLER Mod: ECOMET 3000	1
G1 - Grupo eletrogêneo de motor de pistão - Fabr: Caterpillar Mod: 3516B	1
G2 - Grupo eletrogêneo de motor de pistão - Fabr: Caterpillar Mod: 3516B	1
G3 - Grupo eletrogêneo de motor de pistão - Fabr: Caterpillar Mod: 3516B	1
G4 - Grupo eletrogêneo de motor de pistão - Fabr: Caterpillar Mod: 3516B	1
G5 - Grupo eletrogêneo de motor de pistão - Fabr: Caterpillar Mod: 3516B	1
HARE13 - Máquina automática de armazenamento de retículos - Fabr: PRI Mod: 7800	1
HASO10 - Equipamento com interface SMIF para movimentação, carregamento, descargamento ou transferência entre cassetes de lâminas de silício usadas na fabricação de circuitos integrados. - Fabr: Fortrend Mod: Lamina 202	1
HASO11 - Equipamento com interface SMIF para movimentação, carregamento, descargamento ou transferência entre cassetes de lâminas de silício usadas na fabricação de circuitos integrados. - Fabr: Fortrend Mod: Lamina 202	1

HASO30 - Equipamento com interface SMIF para movimentação, carregamento, descargamento ou transferência entre cassetes de lâminas de silício usadas na fabricação de circuitos integrados. - Fabr: Fortrend Mod: Lamina 202	1
HASO31 - Equipamento com interface SMIF para movimentação, carregamento, descargamento ou transferência entre cassetes de lâminas de silício usadas na fabricação de circuitos integrados. - Fabr: Fortrend Mod: Lamina 202	1
HASO40 - Equipamento com interface SMIF para movimentação, carregamento, descargamento ou transferência entre cassetes de lâminas de silício usadas na fabricação de circuitos integrados. - Fabr: Fortrend Mod: Lamina 202	1
HASO41 - Equipamento com interface SMIF para movimentação, carregamento, descargamento ou transferência entre cassetes de lâminas de silício usadas na fabricação de circuitos integrados. - Fabr: Fortrend Mod: Lamina 202	1
HTAN10 - Forno de recozimento de alta temperatura para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8000 HT ANNEAL	1
HTAN11 - Forno de recozimento de alta temperatura para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8000 HT ANNEAL	1
HTAN12 - Forno de recozimento de alta temperatura para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8000 HT ANNEAL	1
HTBP10 - Forno de recozimento BPSG para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8000 BLA	1
HTBP11 - Forno de recozimento BPSG para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8000 BLA	1
HTCU11 - Forno de recozimento de baixa temperatura para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8200 LTA	1
HTCU12 - Forno de recozimento de baixa temperatura para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8200 LTA	1
HTOX10 - Forno de oxidação térmica para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8000 WDO	1
HTOX11 - Forno de oxidação térmica para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8000 WDO	1
HTOX12 - Forno de oxidação térmica para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8000 WDO	1
HTPI10 - Forno de cura polyimida para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8000 PIC	1
HYMT11 - Instrumento de medida de espessura (refletômetro) - Fabr: Thermawave Mod: 5240	1
HYMT22 - Microscópio óptico - Fabr: OLYMPUS Mod: VANOX AHMT3	1
HYMT31 - Microscópio óptico - Fabr: SIGNATONE Mod: CHECKMATE 100	1
HYMT70 - Instrumento de medida de perfil (perfilômetro) - Fabr: KLA Mod: HRP 220	1
HYPK10 - Corte de Wafer - Fabr: Disco Mod: DFD6341	1
HYPK20 - Afinamento de Wafer - Fabr: Disco Mod: DFG8540	1
HYPK21 - Lâminadora automática - Fabr: Lintec Mod: RAD-3510F/12	1
HYPK22 - Montadora de wafer - Fabr: Lintec Mod: RAD-2500M/8	1
HYPK23 - Cura Ultra Violeta - Fabr: Lintec Mod: RAD-2000M/12	1
HYPL60 - Estabilizador de filmes poliméricos para exposição à radiação ultravioleta - Fabr: FUSION Mod: FUSION GEMINI	1
MTAY10 - Instrumento para medida de tensão mecânica em filmes finos - Fabr: KLA-Tencor Mod: Flexus 5400	1
MTAY20 - Medidor de resistividade elétrica - Fabr: Prometrix Mod: RS75	1
MTAY21 - Medidor de resistividade elétrica - Fabr: Prometrix Mod: RS75	1
MTC10 - Microscópio eletrônico especializado na medida de dimensões críticas - Fabr: Hitachi Mod: S-9220	1
MTC11 - Microscópio eletrônico especializado na medida de dimensões críticas - Fabr: Hitachi Mod: S-9380	1

MTCD20 - Microscópio eletrônico de varredura (S-7800) - Fabr: Hitachi Mod: S-7800	1
MTTO20 - Medidor de topografia de superfície de lâminas - Fabr: KLA-Tencor Mod: HRP 240	1
MTWI20 - Microscópio ótico automatizado - Fabr: Leica Mod: INS3000	1
MTWI21 - Microscópio ótico automatizado - Fabr: Leica Mod: INS3000	1
MTWI22 - Microscópio ótico automatizado - Fabr: Leica Mod: INS3000	1
MTWI23 - Microscópio ótico automatizado - Fabr: Leica Mod: INS2000	1
MTWI24 - Microscópio ótico automatizado - Fabr: Leica Mod: INS2000	1
MTWI25 - Microscópio ótico automatizado - Fabr: Leica Mod: INS2000	1
PCK01 - Encapsuladora por moldagem - Fabr: Boschmann Mod: Pack Star 2	1
PCK02 - Encapsuladora por moldagem - Fabr: Boschmann Mod: Pack Star 2	1
PEDESTAL DE ACO PARA EVITAR VIBRACOES	2 3
PL20K01 - Linha de Personalização RFID - Fabr: Mühlbauer Mod: PL 20000	1
PLTR10 - Máquina automatizada para deposição e revelação de fotoresiste sobre lâminas de silício utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e circuitos integrados - Fabr: TEL Mod: ACT 8	1
PLTR20 - Máquina automatizada para deposição e revelação de fotoresiste sobre lâminas de silício utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e circuitos integrados - Fabr: TEL Mod: ACT 8	1
PLTR21 - Máquina automatizada para deposição e revelação de fotoresiste sobre lâminas de silício utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e circuitos integrados - Fabr: TEL Mod: ACT 8	1
PLTR30 - Máquina automatizada para deposição e revelação de fotoresiste sobre lâminas de silício utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e circuitos integrados - Fabr: TEL Mod: ACT 8	1
PLTR32 - Máquina automatizada para deposição e revelação de fotoresiste sobre lâminas de silício utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e circuitos integrados - Fabr: TEL Mod: ACT 8	1
PLXD11 - Sistema de fotolitografia para exposição de lâminas de semicondutores cobertas com polímeros fotossensível usando luz ultravioleta e máscaras (retículos) para a fabricação de circuitos integrados eletrônicos - Fabr: ASML Mod: PAS 5500/1100	1
PLXI30 - Sistema de fotolitografia para exposição de lâminas de semicondutores cobertas com polímeros fotossensível usando luz ultravioleta e máscaras (retículos) para a fabricação de circuitos integrados eletrônicos. - Fabr: ASML Mod: PAS 5500/400C	1
PLXM20 - Sistema de fotolitografia para exposição de lâminas de semicondutores cobertas com polímeros fotossensível usando luz ultravioleta e máscaras (retículos) para a fabricação de circuitos integrados eletrônicos. - Fabr: ASML Mod: PAS 5500/750F	1
PLXM21 - Sistema de fotolitografia para exposição de lâminas de semicondutores cobertas com polímeros fotossensível usando luz ultravioleta e máscaras (retículos) para a fabricação de circuitos integrados eletrônicos. - Fabr: ASML Mod: PAS 5500/700D	1
TAL15K01 - Máquina para montagem de inlay - Fabr: Mühlbauer Mod: TAL 15000	1
TAL15K02 - Máquina para montagem de inlay - Fabr: Mühlbauer Mod: TAL 15000	1
Testadora de Solda - Fabr: Dage Mod: 4000 TPAXY	1
Teste e Punch Smart Chip - Fabr: Mühlbauer Mod: TI 2280	1
TSFT10 - Equipamento de teste elétrico de circuitos integrados - Fabr: Advantest Mod: V93000	1

TSPR10 - Equipamento para realização e controle de contatos elétricos em plaquetas (wafers) usados na fabricação de circuitos integrados eletrônicos - Fabr: TEL Mod: P8XL	1
TSPR30 - Equipamento para realização e controle de contatos elétricos em plaquetas (wafers) usados na fabricação de circuitos integrados eletrônicos - Fabr: TEL Mod: P8XL	1
UPS 1 - Equipamento de alimentação ininterrupta - Fabr: Caterpillar Mod: UPS Flywheel	1
UPS 2 - Equipamento de alimentação ininterrupta - Fabr: Caterpillar Mod: UPS Flywheel	1
UPS 3 - Equipamento de alimentação ininterrupta - Fabr: Caterpillar Mod: UPS Flywheel	1
UPS 4 - Equipamento de alimentação ininterrupta - Fabr: Caterpillar Mod: UPS Flywheel	1
UPS 5 - Equipamento de alimentação ininterrupta - Fabr: Caterpillar Mod: UPS Flywheel	1
WB01 - Wire Bonder Smart Chip - Fabr: ESEC Mod: WB 3200 SC	1
WB02 - Wire Bonder Smart Chip - Fabr: ESEC Mod: WB 3200 SC	1
WB03 - Wire Bonder Smart Chip - Fabr: ESEC Mod: WB 3200 SC	1
WB04 - Wire Bonder Smart Chip - Fabr: ESEC Mod: WB 3200 SC	1
WB05 - Wire Bonder Smart Chip - Fabr: ESEC Mod: WB 3200 SC	1
WB06 - Wire Bonder Smart Chip - Fabr: ESEC Mod: WB 3200 SC	1
WCBS20 - Equipamento de limpeza de lâminas (wafers) de silício contendo duas câmaras com capacidade de limpeza a face posterior da lâmina na fabricação de circuitos integrados eletrônicos - Fabr: SEZ Mod: SP223	1

- 3.5. Os bens serão alienados no local, no estado e nas condições em que se encontram, eximindo-se o **BNDES** da responsabilidade pela desmontagem, remoção, **transporte** ou por qualquer reparo que venha a ser necessário para o funcionamento dos bens.
- 3.6. O **BNDES** confirma que não há óbices judiciais à venda dos bens incluídos neste processo de alienação.
- 3.7. Não caberá qualquer reclamação posterior quanto às qualidades intrínsecas ou extrínsecas dos bens.
- 3.8. As eventuais dívidas existentes são de responsabilidade do **BNDES** até a data da assinatura do **Termo de Entrega / Recebimento** do bem. Esse termo representa a transferência de propriedade para o **ADQUIRENTE**.
- 3.9. Após a transferência da propriedade dos bens, todos os demais valores devidos serão de responsabilidade do **ADQUIRENTE**, inclusive todos os custos necessários à **retirada e transporte** dos bens da localidade em que se encontrem.
4. **VISTORIA FACULTATIVA:**
- 4.1. A solicitação de vistoria deverá ser previamente solicitada na forma indicada na página eletrônica de divulgação do evento na plataforma Superbid.
- 4.2. Uma vez autorizada a vistoria, o dia e horário serão informados ao interessado. Em caso de descumprimento do horário marcado será necessário realizar uma nova solicitação.
- 4.3. As edificações da UNITEC não dispõem de recursos operacionais no momento. Suas instalações encontram-se sem suprimento de energia, sem iluminação, sem abastecimento de água potável e água para os sanitários e sem sistema de climatização. A empresa interessada na vistoria dos bens deve estar ciente destas condições e viabilizar os recursos julgados necessários para a vistoria.

4.4. O **ADQUIRENTE** não poderá desistir da compra sob alegações quanto ao estado do bem ou quaisquer outros pretextos, respondendo, se assim o fizer, na forma dos artigos 419 do Código Civil.

5. ENVIO DOS LANCES, MODO DE DISPUTA E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

5.1. A alienação se dará por meio de **lote único ou de 19 (dezenove) lotes segregados**, conforme definidos no **Anexo A** deste Projeto Básico, que discrimina a composição dos lotes e os respectivos preços mínimos.

5.2. Serão aceitos lances exclusivamente até a data e horário limite estabelecidos no edital, não sendo admitidos lances após esse prazo.

5.3. Será considerada vencedor o lance que apresentar o **maior valor**, desde que **igual ou superior ao preço mínimo estabelecido** para o lote correspondente.

5.4. Será conferida **prioridade à alienação do lote único**, de modo que, havendo lance válido para sua aquisição, restarão prejudicados os lances ofertados para os lotes segregados.

5.5. O lance deverá qualificar o **PROPONENTE** e conter de forma explícita o **valor ofertado em reais (BRL)**.

5.6. A seleção será pela maior oferta de preço, considerando os centavos até a segunda casa decimal. Em caso de empate pelo valor, a classificação obedecerá a ordem cronológica de recebimento do lance no sistema da plataforma eletrônica, considerando-se o dia, a hora e o minuto.

5.7. O modo de disputa adotado será o aberto. A seleção será pela maior oferta de preço.

5.8. A disputa se dará no ambiente eletrônico da SUPERBID (www.superbid.net), de modo que os interessados deverão estar devidamente cadastrados na referida plataforma, observadas as regras e procedimentos por ela estabelecidos, como condição para participação no processo competitivo e apresentação de propostas.

5.9. Encerrada a fase de recebimento de lances, proceder-se-á com a verificação da aptidão do vencedor. Tal procedimento observará o seguinte:

5.9.1. Pagamento da quantia correspondente ao sinal previsto no item 6.1, que será efetuada na forma descrita no item 6 deste Projeto Básico.

5.9.2. Tratando-se de **PROPONENTE** pessoa física, apresentar a documentação listada nos subitens a seguir:

- a) Documento de identidade;
- b) CPF; e
- c) Declaração de Ausência de Impedimentos, conforme Modelo de Declaração anexo ao Edital.

5.9.3. Tratando-se de **PROPONENTE** pessoa jurídica, apresentar a documentação listada nos subitens a seguir:

- a) Cédula de Identidade ou documento equivalente do Representante Legal ou Procurador do **PROPONENTE**;
- b) Contrato ou Estatuto Social, juntamente com a(s) alteração(ões), que comprove(m) sua capacidade de

representação legal, com expressa previsão dos poderes para se manifestar pelo **PROPONENTE**, oferecer proposta, dar declarações, assim como praticar todos os demais atos pertinentes a este Processo Competitivo. Em caso de administrador eleito em ato apartado, deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição;

c) No caso de Procurador, Instrumento Público ou Particular de Mandato (Procuração), com firma reconhecida em cartório, outorgando expressamente poderes para se manifestar pelo **PROPONENTE**, oferecer proposta, dar declarações, assim como praticar todos os demais atos pertinentes a este Processo Competitivo; e
d) Declaração de Ausência de Impedimentos, conforme Modelo de Declaração anexo ao Edital.

5.10. Em caso de participação de pessoas jurídicas estrangeiras, poderá ser substituída a documentação exigida neste Projeto Básico, mediante solicitação de apresentação de documentação emitida no exterior que seja compatível e/ou equivalente à exigida aos Proponentes sediados no país, observada a legislação vigente.

5.11. Se o **PROPONENTE** não atender às exigências de aptidão, será convocado o próximo colocado, se houver.

5.12. Ao fim do processo, o **BNDES** irá comunicar o resultado ao vencedor, assim como divulgará o aviso deste resultado no site do **BNDES**.

6. PAGAMENTO:

6.1. Os bens somente poderão ser pagos **À VISTA**, em moeda nacional corrente, sendo 10% (dez por cento) do valor do lance em até 2 dias do encerramento do leilão, como sinal, e 90% (noventa por cento) do valor do lance (“valor restante”) em até 30 dias do encerramento do leilão ou antes do início da retirada do bem, o que ocorrer primeiro.

6.2. Em caso de desistência, o **PROPONENTE** se sujeitará à perda dos 10% (dez por cento) pagos à título de sinal, na forma do art. 419 do Código Civil de 2002.

6.3. Os pagamentos serão realizados no ambiente eletrônico da Superbid e posteriormente transferido para o **BNDES**. O **ARREMATANTE** deverá estar apto a realizar os pagamentos através do meio de pagamento disponibilizado pela plataforma eletrônica de vendas (www.superbid.net).

6.4. Eventuais taxas e impostos incidentes sobre a transação serão de responsabilidade do **PROPONENTE**.

6.5. Os prazos previstos neste item podem ser prorrogados, a critério de **BNDES**, desde que o **ARREMATANTE** apresente justificativa para a excepcionalidade do atraso.

6.6. O(s) **PROPONENTE(S)** que não cumprir(em) com a obrigação de realizar o pagamento na forma descrita neste item ou não assinar(em) o **Termo de Entrega / Recebimento**, sujeita(m)-se a perder o valor já pago em favor do **BNDES**, consoante dispõe o art. 419 do Código Civil.

7. DA RETIRADA DOS BENS:

7.1. O **ARREMATANTE** deverá retirar os bens adquiridos do local indicado no item 2.1 deste Projeto Básico em até **120 (cento e vinte) dias corridos**, contados a partir da data de comunicação do resultado do Processo Competitivo, sob pena de os bens serem considerados abandonados pelo **ARREMATANTE**.

7.1.1. Este prazo poderá ser prorrogado, a pedido do **ARREMATANTE**, de maneira justificada e aceita pelo **BNDES**.

7.1.2. Todos os custos necessários à retirada e transporte dos bens da localidade em que se encontram serão de responsabilidade do **ARREMATANTE**.

7.2. O **ARREMATANTE** deverá se informar sobre todas as exigências técnicas da administradora da fábrica para a retirada dos bens, incluindo o intervalo de horário permitido para os trabalhos, os equipamentos autorizados para a desmontagem, movimentação e transporte de carga.

7.3. Antes da retirada dos bens, deverá ser assinado o **Termo de Entrega / Recebimento**, cuja minuta encontra-se no Anexo II, sob pena de perda do direito à aquisição e de não efetivação da retirada e da tradição dos bens.

7.3.1. Os bens somente poderão ser retirados com a comprovação do pagamento do boleto e a assinatura do **Termo de Entrega / Recebimento**, no qual constará:

I – nome, qualificação e assinatura do **ARREMATANTE** ou seu representante legal;

II – data de início da retirada;

III – local da retirada; e

III – identificação do bem, indicando, sempre que possível, a marca, o modelo ou outro elemento.

7.4. Os bens poderão ser entregues ao procurador do **ARREMATANTE**, mediante apresentação de procuração estabelecendo poderes específicos para esse ato.

7.4.1. A procuração deverá ser encaminhada previamente à data agendada para a entrega através do e-mail: processocompetitivo@bndes.gov.br, devendo a via original ser apresentada por ocasião da entrega dos bens.

7.5. A transferência da posse e propriedade dos bens móveis ocorrerá por ocasião da assinatura do **Termo de Entrega / Recebimento** e respectiva entrega dos bens no local onde se encontram armazenados.

7.6. Na hipótese de recusa ou inércia do **ARREMATANTE** em cumprir o disposto nos itens 7 e 8 deste Projeto Básico, caberá ao **BNDES** verificar a possibilidade de retomada do procedimento de alienação com a exclusão do desistente, convocando, em seguida, o próximo colocado.

7.7. Os bens não retirados no prazo serão considerados abandonados pelo **ARREMATANTE**.

8. OBRIGAÇÕES DO(S) ARREMATANTE(S):

8.1. Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, no Edital ou em lei, particularmente na Lei nº 13.303/2016, constituem obrigações do Adquirente:

8.1.1. Efetuar o pagamento através da plataforma Superbid na forma e nas condições estabelecidas no item 6 (PAGAMENTO) deste Projeto Básico;

8.1.2. Retirar os bens adquiridos da localidade em que se encontrem conforme previsto no item 7 (DA RETIRADA DOS BENS);

8.1.3. Atender aos critérios demandados pelo responsável pela unidade industrial, tais como a integração dos prestadores de serviço;

- 8.1.4. Arcar com o pagamento de todas as despesas e encargos relativos à transação, embalagem, carga, descarga e transporte dos bens adquiridos;
- 8.1.5. Assinar o **Termo de Entrega / Recebimento** dos bens, antes da efetiva retirada do local;
- 8.1.6. Respeitar as normas relativas à **disposição final ambientalmente adequada dos bens adquiridos**; e
- 8.1.7. Respeitar todos os critérios técnicos e de segurança interpostos pela operadora da fábrica, no que diz respeito à desmontagem e transporte dos equipamentos.

9. OBRIGAÇÕES DO BNDES:

- 9.1. Além de outras obrigações estabelecidas neste Instrumento, no Edital ou em lei, constituem obrigações do **BNDES**:
 - 9.1.1. Permitir a retirada dos bens pelo **ARREMATANTE**, em sendo cumpridas todas as obrigações previstas no Edital e em todos os seus Anexos; e
 - 9.1.2. Assinar o **Termo de Entrega / Recebimento** dos bens, por ocasião da tradição deles ao **ARREMATANTE**.

ANEXO A – COMPOSIÇÃO DOS LOTES E PREÇOS MÍNIMOS

O presente Anexo estabelece os **lotes de equipamentos disponibilizados para alienação**, bem como os respectivos **valores mínimos para apresentação de propostas**, os quais deverão ser observados pelos interessados.

Os valores indicados correspondem ao **preço mínimo de aceitação**, sendo consideradas válidas apenas as propostas que apresentarem valores **iguais ou superiores** aos aqui estabelecidos.

1. Relação de Lotes e Valores Mínimos

LOTE	VALOR MÍNIMO
Lote 1 (Único)	R\$ 41.493.000,00
Lote 101	R\$ 3.781.500,00
Lote 102	R\$ 1.817.400,00
Lote 103	R\$ 1.773.900,00
Lote 104	R\$ 1.579.100,00
Lote 105	R\$ 2.235.300,00
Lote 106	R\$ 1.748.200,00
Lote 107	R\$ 1.079.000,00
Lote 108	R\$ 8.589.500,00
Lote 109	R\$ 4.289.100,00
Lote 110	R\$ 404.600,00
Lote 111	R\$ 7.953.200,00
Lote 112	R\$ 26.200,00
Lote 113	R\$ 6.063.200,00
Lote 114	R\$ 143.300,00
Lote 115	R\$ 11.500,00
Lote 116	R\$ 122.200,00
Lote 117	R\$ 11.289.000,00
Lote 118	R\$ 2.782.000,00
Lote 119	R\$ 1.494.000,00

2. Composição dos Lotes

Lote 1 (Único)

Valor mínimo: R\$ 41.493.000,00

O Lote Único é composto pela **totalidade dos equipamentos descritos no item 3.4 deste Projeto Básico**.

Lote 101

Valor mínimo: R\$ 3.781.500,00

O Lote 101 é composto pelos equipamentos abaixo listados:

LOTE 101	
Equipamento	Qtde
CL60K01 - Linha de Conversão RFID - Fabr: Mühlbauer Mod: CL 60000	1
PL20K01 - Linha de Personalização RFID - Fabr: Mühlbauer Mod: PL 20000	1
TAL15K01 - Máquina para montagem de inlay - Fabr: Mühlbauer Mod: TAL 15000	1
TAL15K02 - Máquina para montagem de inlay - Fabr: Mühlbauer Mod: TAL 15000	1

Lote 102

Valor mínimo: R\$ 1.817.400,00

O Lote 102 é composto pelos equipamentos abaixo listados:

LOTE 102		
Equipamento	Qtde	Valor
CME01 - Encapsuladora Smart Chip - Fabr: Mühlbauer Mod: CME 3060	1	R\$ 630.800,00
CMT01 - Teste de Encapsulamento Smart Chip - Fabr: Mühlbauer Mod: CMT 6560	1	R\$ 593.300,00
CMT02 - Teste de Encapsulamento Smart Chip - Fabr: Mühlbauer Mod: CMT 6560	1	R\$ 593.300,00

Lote 103

Valor mínimo: R\$ 1.773.900,00

O Lote 103 é composto pelos equipamentos abaixo listados:

LOTE 103	
Equipamento	Qtde
DB01 - Die Bonder Smart Chip - Fabr: ESEC Mod: DB 2008 SC	1

Lote 104

Valor mínimo: R\$ 1.579.100,00

O Lote 104 é composto pelos equipamentos abaixo listados:

LOTE 104	
Equipamento	Qtde
Teste e Punch Smart Chip - Fabr: Mühlbauer Mod: TI 2280	1
WB01 - Wire Bonder Smart Chip - Fabr: ESEC Mod: WB 3200 SC	1
WB02 - Wire Bonder Smart Chip - Fabr: ESEC Mod: WB 3200 SC	1
WB03 - Wire Bonder Smart Chip - Fabr: ESEC Mod: WB 3200 SC	1
WB04 - Wire Bonder Smart Chip - Fabr: ESEC Mod: WB 3200 SC	1
WB05 - Wire Bonder Smart Chip - Fabr: ESEC Mod: WB 3200 SC	1
WB06 - Wire Bonder Smart Chip - Fabr: ESEC Mod: WB 3200 SC	1

Lote 105

Valor mínimo: R\$ 2.235.300,00

O Lote 105 é composto pelos equipamentos abaixo listados:

LOTE 105	
Equipamento	Qtde
DSPA10 - Removedor de polímeros por plasma - Fabr: Axcelis Mod: Gemini GES	1
DSPA11 - Removedor de polímeros por plasma - Fabr: Axcelis Mod: Gemini GES	1
DSPA12 - Removedor de polímeros por plasma - Fabr: Fusion Mod: Gemini GPL	1
DSPA13 - Removedor de polímeros por plasma - Fabr: Fusion Mod: Gemini GES	1
DSPA14 - Removedor de polímeros por plasma - Fabr: Fusion Mod: Gemini GPL	1
DSPA20 - Removedor de polímeros por plasma - Fabr: EATON Mod: Gemini GES	1
DSPA21 - Removedor de polímeros por plasma - Fabr: FUSION Mod: Gemini GPL	1



<p>FAIA60 - Equipamento para elevação e movimentação de plaquetas (wafers), de dispositivos semicondutores e circuitos eletrônicos integrados provendo contatos elétricos - Fabr: KARL SUSS Mod: PA200</p>	<p>1</p>
<p>FASP10 - Equipamento de deposição de metais utilizado nas plaquetas (wafers) de dispositivos semicondutores para a fabricação de circuitos integrados eletrônicos - Fabr: OXFORD Mod: PLASMALAB 80</p>	<p>1</p>
<p>FASP11 - Equipamento de deposição de metais utilizado nas plaquetas (wafers) de dispositivos semicondutores para a fabricação de circuitos integrados eletrônicos - Fabr: NEXTRAL Mod: NE90</p>	<p>1</p>
<p>FASP40 - Equipamento de deposição de metais utilizado nas plaquetas (wafers) de dispositivos semicondutores para a fabricação de circuitos integrados eletrônicos - Fabr: MSCOPE Mod: SC500</p>	<p>1</p>
<p>FASP60 - Equipamento para polimento de wafers utilizado na fabricação de dispositivos semicondutores - Fabr: PRESI Mod: MINITECH 233</p>	<p>1</p>
<p>FASP61 - Equipamento para polimento de wafers utilizado na fabricação de dispositivos semicondutores - Fabr: BUEHLER Mod: ECOMET 3000</p>	<p>1</p>
<p>HYPL60 - Estabilizador de filmes poliméricos para exposição à radiação ultravioleta - Fabr: FUSION Mod: FUSION GEMINI</p>	<p>1</p>
<p>TSPR10 - Equipamento para realização e controle de contatos elétricos em plaquetas (wafers) usados na fabricação de circuitos integrados eletrônicos - Fabr: TEL Mod: P8XL</p>	<p>1</p>
<p>EFPE10 - LAM Kiyo system - Fabr: LAM Mod: 2300 (no grupo dos geminis)</p>	<p>1</p>
<p>TSPR30 - Equipamento para realização e controle de contatos elétricos em plaquetas (wafers) usados na fabricação de circuitos integrados eletrônicos - Fabr: TEL Mod: P8XL</p>	<p>1</p>
<p>WCBS20 - Equipamento de limpeza de lâminas (wafers) de silício contendo duas câmaras com capacidade de limpeza a face posterior da lâmina na fabricação de circuitos integrados eletrônicos - Fabr: SEZ Mod: SP223</p>	<p>1</p>
<p>AVP kit de atualização: AVP computador de gerenciamento - Mod: SPTS AMS Server</p>	<p>1</p>

Lote 106

Valor mínimo: R\$ 1.748.200,00

O Lote 106 é composto pelos equipamentos abaixo listados:

<p>LOTE 106</p>	
<p>Equipamento</p>	<p>Qtde</p>
<p>HYPK10 - Corte de Wafer - Fabr: Disco Mod: DFD6341</p>	<p>1</p>
<p>HYPK20 - Afinamento de Wafer - Fabr: Disco Mod: DFG8540</p>	<p>1</p>

HYPK21 - Lâminadora automática - Fabr: Lintec Mod: RAD-3510F/12	1
HYPK22 - Montadora de wafer - Fabr: Lintec Mod: RAD-2500M/8	 1
HYPK23 - Cura Ultra Violeta - Fabr: Lintec Mod: RAD-2000M/12	1
TSFT10 - Equipamento de teste elétrico de circuitos integrados - Fabr: Advantest Mod: V93000	1
HYMT11 - Instrumento de medida de espessura (refletômetro) - Fabr: Thermawave Mod: 5240	1
HYMT70 - Instrumento de medida de perfil (perfilômetro) - Fabr: KLA Mod: HRP 220	1
MTCD10 - Microscópio eletrônico especializado na medida de dimensões críticas - Fabr: Hitachi Mod: S-9220	1
MTCD11 - Microscópio eletrônico especializado na medida de dimensões críticas - Fabr: Hitachi Mod: S-9380	1
MTCD20 - Microscópio eletrônico de varredura (S-7800) - Fabr: Hitachi Mod: S-7800	1
MTTO20 - Medidor de topografia de superfície de lâminas - Fabr: KLA-Tencor Mod: HRP 240	1

Lote 107

Valor mínimo: R\$ 1.079.000,00

O Lote 107 é composto pelos equipamentos abaixo listados:

LOTE 107	
Equipamento	Qtde
PCK01 - Encapsuladora por moldagem - Fabr: Boschmann Mod: Pack Star 2(separados ou com bonders)	1
PCK02 - Encapsuladora por moldagem - Fabr: Boschmann Mod: Pack Star 2	1

Lote 108

Valor mínimo: R\$ 8.589.500,00

O Lote 108 é composto pelos equipamentos abaixo listados:

LOTE 108	
Equipamento	Qtde
PLXD11 - Sistema de fotolitografia para exposição de lâminas de semicondutores cobertas com polímeros fotossensível usando luz ultravioleta e máscaras (retículos) para a fabricação de circuitos integrados eletrônicos - Fabr: ASML Mod: PAS 5500/ 1100 (compra para spare parts, poucos operadores atualmente0.	1
PLXI30 - Sistema de fotolitografia para exposição de lâminas de semicondutores cobertas com polímeros fotossensível usando luz ultravioleta	1

PLXM20 - Sistema de fotolitografia para exposição de lâminas de semicondutores cobertas com polímeros fotossensível usando luz ultravioleta e máscaras (retículos) para a fabricação de circuitos integrados eletrônicos. -
Fabr: ASML Mod: PAS 5500/750F

1

PLXM21 - Sistema de fotolitografia para exposição de lâminas de semicondutores cobertas com polímeros fotossensível usando luz ultravioleta e máscaras (retículos) para a fabricação de circuitos integrados eletrônicos. -
Fabr: ASML Mod: PAS 5500/700D

1

Lote 109

Valor mínimo: R\$ 4.289.100,00

O Lote 109 é composto pelos equipamentos abaixo listados:

LOTE 109	
Equipamento	Qtde
HTAN10 - Forno de recozimento de alta temperatura para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8000 HT ANNEAL	1
HTAN11 - Forno de recozimento de alta temperatura para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8000 HT ANNEAL	1
HTAN12 - Forno de recozimento de alta temperatura para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8000 HT ANNEAL	1
HTBP10 - Forno de recozimento BPSG para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8000 BLA	1
HTBP11 - Forno de recozimento BPSG para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8000 BLA	1
HTCU11 - Forno de recozimento de baixa temperatura para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8200 LTA	1
HTCU12 - Forno de recozimento de baixa temperatura para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8200 LTA	1
HTOX10 - Forno de oxidação térmica para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8000 WDO	1
HTOX11 - Forno de oxidação térmica para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8000 WDO	1
HTOX12 - Forno de oxidação térmica para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8000 WDO	1
HTPI10 - Forno de cura polyimida para fabricação de semicondutor - Fabr: SVG Mod: AVP-8000 PIC	1

Lote 110

Valor mínimo: R\$ 404.600,00

O Lote 110 é composto pelos equipamentos abaixo listados:

LOTE 110	
Equipamento	Qtde
HARE13 - Máquina automática de armazenamento de retículos - Fabr: PRI Mod: 7800	1
HASO10 - Equipamento com interface SMIF para movimentação, carregamento, descargamento ou transferência entre cassetes de lâminas de silício usadas na fabricação de circuitos integrados. - Fabr: Fortrend Mod: Lamina 202	1
HASO11 - Equipamento com interface SMIF para movimentação, carregamento, descargamento ou transferência entre cassetes de lâminas de silício usadas na fabricação de circuitos integrados. - Fabr: Fortrend Mod: Lamina 202	1
HASO30 - Equipamento com interface SMIF para movimentação, carregamento, descargamento ou transferência entre cassetes de lâminas de silício usadas na fabricação de circuitos integrados. - Fabr: Fortrend Mod: Lamina 202	1
HASO31 - Equipamento com interface SMIF para movimentação, carregamento, descargamento ou transferência entre cassetes de lâminas de silício usadas na fabricação de circuitos integrados. - Fabr: Fortrend Mod: Lamina 202	1
HASO40 - Equipamento com interface SMIF para movimentação, carregamento, descargamento ou transferência entre cassetes de lâminas de silício usadas na fabricação de circuitos integrados. - Fabr: Fortrend Mod: Lamina 202	1
HASO41 - Equipamento com interface SMIF para movimentação, carregamento, descargamento ou transferência entre cassetes de lâminas de silício usadas na fabricação de circuitos integrados. - Fabr: Fortrend Mod: Lamina 202	1

Lote 111

Valor mínimo: R\$ 7.953.200,00

O Lote 111 é composto pelos equipamentos abaixo listados:

LOTE 111	
Equipamento	Qtde
PLTR10 - Máquina automatizada para deposição e revelação de fotoresiste sobre lâminas de silício utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e circuitos integrados - Fabr: TEL Mod: ACT 8	1
PLTR20 - Máquina automatizada para deposição e revelação de fotoresiste sobre lâminas de silício utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e circuitos integrados - Fabr: TEL Mod: ACT 8	1
PLTR21 - Máquina automatizada para deposição e revelação de fotoresiste sobre lâminas de silício utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e circuitos integrados - Fabr: TEL Mod: ACT 8	1
PLTR30 - Máquina automatizada para deposição e revelação de fotoresiste sobre lâminas de silício utilizadas na fabricação de dispositivos semicondutores e circuitos integrados - Fabr: TEL Mod: ACT 8	1

Lote 112

Valor mínimo: R\$ 26.200,00

O Lote 112 é composto pelos equipamentos abaixo listados:

LOTE 112	
Equipamento	Qtde
MTWI20 - Microscópio ótico automatizado - Fabr: Leica Mod: INS3000	1
MTWI21 - Microscópio ótico automatizado - Fabr: Leica Mod: INS3000	1
MTWI22 - Microscópio ótico automatizado - Fabr: Leica Mod: INS3000	1
MTWI23 - Microscópio ótico automatizado - Fabr: Leica Mod: INS2000	1
MTWI24 - Microscópio ótico automatizado - Fabr: Leica Mod: INS2000	1
MTWI25 - Microscópio ótico automatizado - Fabr: Leica Mod: INS2000	1

Lote 113

Valor mínimo: R\$ 6.063.200,00

O Lote 113 é composto pelos equipamentos abaixo listados:

LOTE 113	
Equipamento	Qtde
Pedestal de concreto e aço - Fabr: Fulcrum Mod: ASML PAS 5500	4
PEDESTAL DE ACO PARA EVITAR VIBRACOES	5
Pedestal de aço TEL ACT 8A modulo 1	4
PEDESTAL DE CONCRETO E ACO	5
Pedestal de concreto e aço para evitar vibrações nos equipamentos - Fabr: Fulcrum Mod: KLA HRP-200	1
Pedestal de concreto e aço para evitar vibrações nos equipamentos - PEDESTAL HITACHI S7800	1
Pedestal de concreto e aço para evitar vibrações nos equipamentos - PEDESTAL HITACHI S9220	1

Lote 114

Valor mínimo: R\$ 143.300,00

O Lote 114 é composto pelos equipamentos abaixo listados:

LOTE 114	
Equipamento	Qtde
FAIA10 - Microscópio eletrônico de varredura utilizado para a caracterização microestrutural de semicondutores - Fabr: HITACHI Mod: S-4700	1
FAIA40 - Microscópio óptico - Fabr: NIKON Mod: OPTIPHOT 200C	1
FAIA41 - Microscópio óptico - Fabr: LEICA Mod: POLYVAR-MET	1
FAIA42 - Microscópio óptico - Fabr: ZEISS Mod: AXIOTRON	1
HYMT22 - Microscópio óptico - Fabr: OLYMPUS Mod: VANOX AHMT3	1
HYMT31 - Microscópio óptico - Fabr: SIGNATONE Mod: CHECKMATE 100	1

Lote 115

Valor mínimo: R\$ 11.500,00

O Lote 115 é composto pelos equipamentos abaixo listados:

LOTE 115	
Equipamento	Qtde
MTAY10 - Instrumento para medida de tensão mecânica em filmes finos - Fabr: KLA-Tencor Mod: Flexus 5400	1
MTAY20 - Medidor de resistividade elétrica - Fabr: Prometrix Mod: RS75	1
MTAY21 - Medidor de resistividade elétrica - Fabr: Prometrix Mod: RS75	1

Lote 116

Valor mínimo: R\$ 122.200,00

O Lote 116 é composto pelos equipamentos abaixo listados:

LOTE 116

Equipamento	Qtde
FAIA21 - Equipamento baseado em feixes de ions focalizados, para eliminaçã de matéria, análise e modificação de circuitos Integrados - Fabr: CREDENCE Mod: OPTIFIB III	1
Testadora de Solda - Fabr: Dage Mod: 4000 TPAXY	1



Lote 117

Valor mínimo: R\$ 11.289.000,00

O Lote 117 é composto pelos equipamentos abaixo listados:

LOTE 117	
Equipamento	Qtde
G1 - Grupo eletrogêneo de motor de pistão - Fabr: Caterpillar Mod: 3516B	1
G2 - Grupo eletrogêneo de motor de pistão - Fabr: Caterpillar Mod: 3516B	1
G3 - Grupo eletrogêneo de motor de pistão - Fabr: Caterpillar Mod: 3516B	1
G4 - Grupo eletrogêneo de motor de pistão - Fabr: Caterpillar Mod: 3516B	1
G5 - Grupo eletrogêneo de motor de pistão - Fabr: Caterpillar Mod: 3516B	1

Lote 118

Valor mínimo: R\$ 2.782.000,00

O Lote 118 é composto pelos equipamentos abaixo listados:

LOTE 118	
Equipamento	Qtde
UPS 1 - Equipamento de alimentação ininterrupta - Fabr: Caterpillar Mod: UPS Flywheel (sucata)	1
UPS 2 - Equipamento de alimentação ininterrupta - Fabr: Caterpillar Mod: UPS Flywheel	1
UPS 3 - Equipamento de alimentação ininterrupta - Fabr: Caterpillar Mod: UPS Flywheel	1
UPS 4 - Equipamento de alimentação ininterrupta - Fabr: Caterpillar Mod: UPS Flywheel	1
UPS 5 - Equipamento de alimentação ininterrupta - Fabr: Caterpillar Mod: UPS Flywheel	1

Lote 119

Valor mínimo: R\$ 1.494.000,00

O Lote 119 é composto pelos equipamentos abaixo listados:

LOTE 119

Equipamento	Qtde
BOMBA A VACUO 40x20	2
BOMBA A VACUO 40x20	1
BOMBA A VACUO A07V	3
BOMBA A VACUO A10S	24
BOMBA A VACUO A70W	16
BOMBA A VACUO A70W	11
BOMBA A VACUO A70WN	1
BOMBA A VACUO A70WN	1
BOMBA A VACUO EV-S100P	3
BOMBA A VACUO EV-S100P	2
Bombas de vácuo A10S	15
Bombas de vácuo A10S	8
Bombas de vácuo A10S	6
Bombas de vácuo A10S	6
Bombas de vácuo A10S	2
Bombas de vácuo A70W	16
Bombas de vácuo A70W	11
Bombas de vácuo A70W	6



3. Disposições Gerais

Os equipamentos integrantes de cada lote encontram-se detalhados nas respectivas tabelas acima, sendo vedada a apresentação de propostas parciais dentro de um mesmo lote, devendo as propostas contemplar a totalidade dos bens que o compõem.

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

_____, CNPJ nº ____, sediada em _____, por intermédio de seu Representante Legal, o(a) Sr(a). _____, inscrito no CPF sob o nº _____, DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência de impedimentos normativos à contratação com o BNDES ou suas subsidiárias¹, declarando ainda que:

I. em relação ao art. 38 da Lei n.º 13.303/2016:

- a) não possui administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social que seja diretor ou empregado do BNDES ou de suas subsidiárias;
- b) não está cumprindo penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES ou com suas subsidiárias;
- c) não foi declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
- d) não possui sócio ou administrador que seja sócio de outra empresa que está suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- e) não possui sócio ou administrador que tenha sido sócio ou administrador de outra empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- f) que não tem, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea; e
- g) que não possui sócio que tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com o BNDES ou suas subsidiárias há menos de 6 (seis) meses.

II. não está proibido de licitar e contratar com a Administração Pública, bem como de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de pessoas jurídicas de direito público ou de pessoas jurídicas controladas pelo Poder Público²;

III. em relação ao art. 48 da Lei n.º 13.303/2016, quando se tratar de obras e serviços de engenharia:

- a) não elaborou o anteprojeto ou o projeto básico da licitação e/ou contratação, isoladamente ou por meio de consórcio; e

¹ BNDES Participações S/A – BNDESPAR e a Agência Especial de Financiamento Industrial – FINAME

² Este inciso alcança todas as sanções de impedimento de licitar e contratar previstas nos demais dispositivos legais, tais como as decorrentes da Lei nº 8.429/1992, da Lei nº 9.605/1998, da Lei nº 9.504/1997 e as decorrentes de práticas lesivas à Administração Pública nos termos da Lei nº 12.846/2013.

b) não possui administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante, que tenha sido autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação e/ou da contratação.

IV. em relação à Política de Equidade de Gênero e Valorização da Diversidade do Sistema BNDES (Res. CA nº 04/2024 - BNDES)³, inexistente decisão administrativa final sancionadora, exarada por autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos, pela sociedade ou por seus dirigentes, que importem em discriminação de raça ou gênero, exploração irregular, ilegal ou criminosa do trabalho infantil ou prática relacionada ao trabalho em condições análogas à escravidão, e/ou de sentença condenatória transitada em julgado, proferida em decorrência dos referidos atos, ou ainda, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual, ou importem em crime contra o meio ambiente;

V. em relação à Política para Transações com Partes Relacionadas (Res. CA nº 17/2023 – BNDES):

a) não é controlada por Superintendente, Diretor ou membro de Órgão previsto no estatuto social das empresas do Sistema BNDES;

b) não é controlada por cônjuge, companheiro ou parentes, consanguíneos ou afins, até o 2º grau, de qualquer pessoa referida no inciso (i) acima;

VI. não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos quatorze anos;

VII. se compromete a informar ao BNDES, a qualquer tempo, a alteração das condições declaradas acima;

VIII. está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la;

IX. não possui administrador ou sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito do BNDES; e

X. não designará, para a execução dos serviços ora contratados, profissionais que sejam cônjuge, companheiro(a) ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de empregado ou dirigente do Sistema BNDES.

³ Disponível em <https://ri.bndes.gov.br/governanca-corporativa/estatutos-codigo-e-politicas>.

Local, data.

Assinatura do representante legal.

